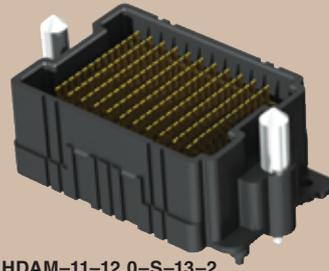




(2,00mm) .0787"

HDAM, HDAF 系列



HDAM-11-12.0-S-13-2



HDAF-11-08.0-S-13-2

加高紧固型高密度阵列

HDAM 配接:
HDAF
HDAF 配接:
HDAM

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?HDAM,
www.samtec.com?HDAF

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物
触点材料:
铜合金
额定电流:
环境温度 80°C 时为 2.3A
工作温度范围:
-55°C 至 +125°C
电镀:
在 50μ" (1.27μm)
的镍上镀金或锡
触点电阻:
19 mΩ 最大
工作电压:
200 VAC
配接次数:
100
符合 RoHS 规范要求:
是
可无铅焊接:
是



HDAM	每排引脚数	引线式样	电镀选项	排数	焊接类型	其他选项
	-11, -15, -23	从图表中指定引线式样	-S = 触点区域镀 30μ" (0.76μm) 的金, 焊尾和焊接片镀雾锡	-13	-2 = 无铅锡阵列 95.5% 锡/ 3.8% 银/.7% 铜 焊接	-P = 取放垫

(22.50) .886
(2.00) .0787
1A
1M
每排引脚数 X (2.00) .0787 + (16.06) .632

A
(5.09) .200
每排引脚数 X (2.00) .0787 + (11.55) .455

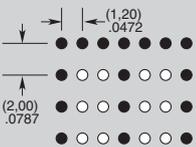
引线式样	A
-12.0	(14.41) .567
-17.0	(19.41) .764

• 整体式导柱

35mm 堆叠高度	在 3dB 插入损耗的额定值*
单端信号	9.0 GHz / 18.0 Gbps
差分对信号	9.0 GHz / 18.0 Gbps

*数据基于使用 Final Inch® 设计进行的模拟。
如需完整测试数据, 请浏览 www.samtec.com?HDAM,
www.samtec.com?HDAF 或联系 sig@samtec.com

差分应用



阵列	对数*
11x13	44
15x13	60
23x13	92

*2:1 S.G 比例

还提供

锡铅焊接。
请致电 Samtec。

注: 提供其他镀金选项。
请联系 Samtec。

注: HD Mezz 是 Molex Incorporated 的商标

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。

HDAF	每排引脚数	引线式样	电镀选项	排数	焊接类型	其他选项
	-11, -15, -23	从图表中指定引线式样	-S = 触点区域镀 30μ" (0.76μm) 的金, 焊尾和焊接片镀雾锡	-13	-2 = 无铅锡阵列 95.5% 锡/ 3.8% 银/.7% 铜 焊接	-P = 取放垫

(22.50) .886
(2.00) .0787
1A
1M
每排引脚数 X (2.00) .0787 + (11.55) .455

A
(17.92) .706
每排引脚数 X (2.00) .0787 + (11.55) .455

引线式样	A
-08.0	(10.51) .414
-18.0	(20.51) .807

• 整体式导柱